

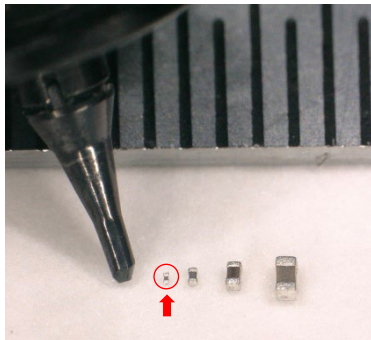
世界首创* !! FUJI 成功实现在电路板上 贴装极小元件 — 016008M

~追求面向人工智能时代的新一代贴装技术~

株式会社 FUJI(公司总部: 爱知县知立市、代表取缔役社长: 五十楼 丈二、以下简称“FUJI”)致力于研发用于贴装下一代极小元件的先进贴装设备技术, 现已通过电子元件贴装机器人(贴片机)“NXTR”成功实现了在电路板上贴装 016008M (0.16×0.08mm)元件。这在全球范围内是首例*。这项技术成果将于 2026 年 1 月 21 日起, 在日本东京有明国际展览中心举办的“第 40 届 INTERNEPCON JAPAN 展”上进行展示。

*本公司的调研结果(截止到 2026 年 1 月 15 日)

近年来, 端侧 AI“边缘人工智能”的发展正在加速, 我们正迈向一个全新的时代: 身边的各种设备, 如智能手机、可穿戴设备, 乃至医疗和保健设备, 都具备信息自主分析能力。在这样的形势下, 电子设备的性能将不断提升, 电子元件的贴装数量将由此而进一步增加。电子元件的进一步微型化与高密度配置已成为不可回避的重要技术课题。



016008M 元件与已经实际应用的元件的尺寸对比

0201M(0.25×0.125mm)元件是目前实际应用中最小规格的电子元件。然而, 为了在有限的电路板空间内实现更多功能, 电子元件的贴装密度将不断增大, 最终势必会达到极限。因此, 业界一直在积极推进下一代标准—016008M 元件的研发。016008M 元件的贴装面积比 0201M 元件少一半左右, 从而可以实现更高密度的电路设计。

■ 凭借四项关键控制技术在全球率先实现了 016008M 元件贴装

FUJI 致力于提供高速、高精度且稳定地贴装极小元件的贴片机。这次, 我们通过对四项关键控制技术的进一步革新, 在全球范围内首次成功实现了在电路板上贴装 016008M 元件。

1. 元件搬运姿势识别

实时检测极小元件的倾斜和姿势, 从而实现最理想的元件搬运。

2. 高精度元件吸取控制

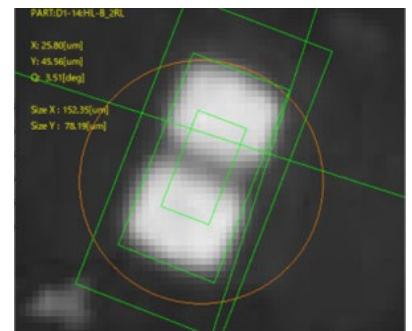
抑制吸取偏移和静电的影响, 从而确保元件吸取的稳定。

3. 贴装压力超精细控制

精确地控制压力, 使贴装压力不会损坏极小元件。

4. 超高精度贴装定位控制

借助纳米级位置补正技术实现了行业最高水准的贴装精度。



高分辨率相机拍摄的 016008M 元件

■ 为贴装下一代极小元件提供综合性解决方案

为了贴装 016008M 以下尺寸的元件，优化工作不能只停留在贴装工序，而是需要对包括电路板设计、锡膏材料、钢网、回焊炉和检查等方面在内的整个贴装过程进行全面优化。

为了迎接边缘人工智能时代的全面到来，FUJI 不仅致力于研发先进的贴装设备技术，还在不断深化与商业伙伴的合作，以此来打造涵盖生产材料、辅助材料的总和性解决方案，推动电子元件微型化竞争迈向新的赛道。

■ 第 40 届 INTERNEPCON JAPAN 展 参展通知

FUJI 将在“第 40 届 INTERNEPCON JAPAN 展”上展出 016008M 元件的贴装技术。

FUJI 参展概要

参展展会：第 40 届 INTERNEPCON JAPAN 展

举办时间：2026 年 1 月 21 日(星期三)~1 月 23 日(星期五) 10:00~17:00

举办地点：日本东京有明国际展览中心

官方网站：<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/zh-cn.html#/>

FUJI 展位：东 4 展厅 E1-52

※关于参展内容，请参阅以下 PDF。

 [INTERNEPCON JAPAN2026 展会信息 PDF\(Exhibition information PDF\)](#)

公司概况

公司名称：株式会社 FUJI

法人代表：代表取缔役社长 五十棲 丈二

公司地址：爱知县知立市山町茶碓山 19 邮编：472-8686

成立时间：1959 年 4 月

事业内容：电子元件贴装机器人(贴片机)以及数控机床的研发、制造、销售

注册资金：58.78 亿日元

网 站：<https://www.fuji.co.jp/cn/> (官方网站)

<https://smt.fuji.co.jp/cn/> (SMT 专用网站)

关于展会的咨询窗口

株式会社 FUJI 营业企画部 展会负责人 [Contact form](#)

各种媒体的咨询窗口

株式会社 FUJI 经营企画部 宣传负责人 [Contact form](#)